

トレックス・セミコンダクター株式会社
品質保証部

成分表

製品名(鉛フリー): XC6216Bxxx8R-G

標準質量: 2.3 mg

名称	質量(mg)	物質名称	構成比率(ppm)	CAS No.
シリコンチップ	0.308	シリコン	134000	7440-21-3
リードパッド	0.645	ニッケル	280600	7440-02-0
	0.061	銀	26700	7440-22-4
	0.007	金	3100	7440-57-5
ダイアタッチ	0.002	シリカ	1000	60676-86-0
	0.001	エポキシ樹脂	500	—
	0.001	フェノール樹脂	300	—
	0.001	アクリル樹脂	300	—
ボンディングワイヤ	0.030	金	13200	7440-57-5
封止樹脂	1.149	熔融シリカ	499800	60676-86-0
	0.093	エポキシ樹脂	40500	—

※ 成分組成は、ベンダーからの情報を元に算出しております。機密情報保持の為、
開示されない情報があり、全内容を保証するものではありません。

※ 重量、構成比率については、材料等の製造条件によって異なることがあります。

※ CASNo.欄で「-」と表記された物質は、社外秘とさせて頂いております。